

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第3区分

【発行日】平成28年10月13日(2016.10.13)

【公開番号】特開2015-42001(P2015-42001A)

【公開日】平成27年3月2日(2015.3.2)

【年通号数】公開・登録公報2015-014

【出願番号】特願2013-173920(P2013-173920)

【国際特許分類】

H 03 F 1/56 (2006.01)

H 03 H 11/28 (2006.01)

H 03 H 7/38 (2006.01)

H 03 F 3/195 (2006.01)

H 03 F 3/60 (2006.01)

【F I】

H 03 F 1/56

H 03 H 11/28

H 03 H 7/38 C

H 03 F 3/195

H 03 F 3/60

【手続補正書】

【提出日】平成28年8月22日(2016.8.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

上面に信号配線、および接地パターンを有する基板と、

前記基板の上面に設けられ、出力端子を備え、前記出力端子が前記信号配線に接続された半導体チップと、

前記基板とは別の絶縁体により形成され、前記基板上に設けられた部品と、を具備し、

前記部品は、前記信号配線との間に前記絶縁体を介して対向する第1パターン、前記接地パターンと接続される第2パターン、および前記第1パターンおよび前記第2パターンとの間を接続してなる第3パターンを有することを特徴とする半導体装置。

【請求項2】

前記第1パターンは前記部品の内部に設けられ、

前記第1パターンと前記第3パターンとを接続するビア配線を具備することを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】

前記部品は、前記第2パターンと前記第3パターンとの間であって、前記部品の側面に、前記第3パターンより幅の大きい第4パターンを有することを特徴とする請求項1または2に記載の半導体装置。